PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09181376 A

(43) Date of publication of application: 11.07.97

(51) Int. CI

H01S 3/0933

H01S 3/00

H01S 3/042 H01S 3/18

(21) Application number: 07338534

(21) Application number. 0700004

(22) Date of filing: 26.12.95

(71) Applicant:

MITSUBISHI HEAVY IND LTD

(72) Inventor:

NODA OSAMU

KURIBAYASHI SHIZUMA WATABE MASAHARU

(54) SEMICONDUCTOR LASER FOR PUMPING SOLID STATE LASER AND FABRICATION THEREOF

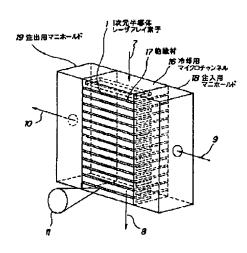
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce a high output with high efficiency by setting the oscillation wavelength of an array element shorter than the absorbing wavelength of a solid state laser medium in a normal temperature thereby turning the absorption spectrum of solid state laser medium to the oscillation spectrum of a high output pumping semiconductor laser.

17 SOLUTION: Insulators one-dimensional and semiconductor laser array elements 1 are arranged between a large number of stacked cooling microchannels 16 such that they are not overlapped in plan view. The cooling microchannels 16 are bonded electrically and physically to the one-dimensional semiconductor laser array elements 1 thus constituting a two-dimensional semiconductor laser array element. The wavelength indicative of the peak value of oscillation spectrum of the one-dimensional semiconductor laser array elements 1 during normal operation in a normal temperature is shifted by an amount corresponding to the wavelength shift at the temperature rise of semiconductor laser during high output operation, to the short wavelength side from the peak wavelength of Nd ion

absorption spectrum and tuned with the peak wavelength of Nd ion.

COPYRIGHT: (C)1997 JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-181376

(43)公開日 平成9年(1997)7月11日

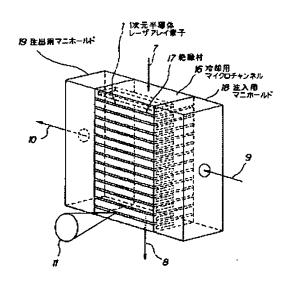
(51) Int.CL ⁸		織別配号	庁内整理番号	ΡI			3	支術表 示	葡萄
H015	3/0933			HOIS	3/091		S		
	3/00				3/00		В		
	3/042				3/18				
	3/18				3/04		L		
				容在爺求	未說求	節求項の数 6	oL	(全 8	頁)
(21)出顧番号	<u> </u>	特顧平7 - 338534		(71)出顧人	000006208				
					三菱里	工業株式会社			
(22)出顧日		平成7年(1995)12		東京都千代田区丸の内二丁自5番1号					
				(72)発明者	野田	B			
					兵庫県高砂市荒井町新浜二丁目1番1号				
					三菱里工業株式会社高砂研究所内				
			-	(72)発明者	栗林	志頭真			
					兵庫県	高砂市荒井町新	英二丁 [11番1	号
					三菱重	工業株式会社高	砂研究的	竹内	
				(72)発明者	凌部	正治			
					兵庫県高砂市荒井町新浜二丁目1番1号				
				三菱面	三菱重工學株式会社高砂研究所內				
				(74)代理人	弁理士	光石 使邮	(9 1-24	ጅ ን	

(54) 【発明の名称】 固体レーザ励起用半導体レーザ及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 固体レーザ媒質の吸収スペクトルと高出力励起用半導体レーザの発振スペクトルの同調が可能で、高効率で高出力の固体レーザ発振が達成できる固体レーザ励起用半導体レーザを提供することを目的とする。

【解決手段】 固体レーザを光励起するための光源として半導体レーザの一次元アレイ素子1を二次元的に配置してなる固体レーザ励起用半導体レーザにおいて、前記固体レーザ鍵貿の吸収波長帯と前記アレイ素子の発振波長帯を同調させるために、前記アレイ素子1の発振波長を常温状態で前記固体レーザ媒質の吸収波長帯より短波長側としたことを特徴とする。



(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 固体レーザを光励起するための光源として半導体レーザの一次元アレイ素子を二次元的に配置してなる固体レーザ励起用半導体レーザにおいて、前記固体レーザ媒質の吸収波長帯と前記アレイ素子の発振波長 帯を同調させるために、前記アレイ素子の発振波長を常温状態で前記固体レーザ媒質の吸収波長帯より短波長側としたことを特徴とする固体レーザ励起用半導体レーザ、

1

【請求項2】 固体レーザを光励起するための光源とし 10 て半導体レーザの一次元アレイ素子を二次元的に配置してなる固体レーザ励起用半導体レーザにおいて、前記固体レーザ機質の吸収液長帯と前記アレイ素子の発振液長帯の幅を同調させるために、絶縁冷媒の流れる冷却用マイクロチャンネルと前記アレイ素子とを交互に繰り返して情層することにより二次元半導体レーザアレイ素子を構成すると共に設二次元半導体レーザアレイ素子の両側面に前記冷却用マイクロチャンネルに対して前記絶縁冷媒を並列的に注水する注水用マニホールド及び集合して注出する注出用マニホールドをそれぞれ一直に結合した 20 ことを特徴とする固体レーザ励起用半導体レーザ。

【請求項3】 前記冷却用マイクロチャンネルは、単一 流路であることを特徴とする請求項2記載の固体レーザ 励起用半導体レーザ。

【請求項4】 前記冷却用マイクロチャンネルは、一体物であることを特徴とする請求項2記銭の固体レーザ励起用半導体レーザ。

【請求項5】 前記注入用マニホールドを経て、前記冷 **却用マイクロチャンネルを単一流路として通過した絶縁** 冷媒が再び前記冷却用マイクロチャンネルを通過するこ となく、前記注出用マニホールドへ流出することを特徴 とする請求項2記載の固体レーザ励起用半導体レーザ。 【論求項6】 導電材によりなる冷却用マイクロチャン ネルの間に、絶縁体と一次元半導体レーザアレイ素子と を平面的に重なり合わないように並べて挟み込むと共に 前記冷却用マイクロチャンネルと一次元半導体レーザア レイ素子との間に導電性接着剤を介装したものを複数個 **結層して二次元半導体レーザアレイ素子として所定の圧** 力でクランプするプロセスと、前記導電性接着材が溶融 する温度まで前記二次元半導体レーザアレイ素子を加熱 した後、前記導電性接着材が固化するまで冷却させるこ とにより、前記一次元半導体レーザアレイ素子と前記冷 却用マイクロチャンネルとを前記導電性接着剤により物 理的及び電気的に接合するプロセスと、前記二次元半導 体レーザアレイ素子の両側面に往入用マニホールド及び 注出用マニホールドを接合するプロセスとを有すること を特徴とする固体レーザ励起用半導体レーザの製造方

【発明の詳細な説明】 【0001】 【発明の屑する技術分野】本発明は、固体レーザ励起用 半導体レーザ及びその製造方法に関する。特に、高出力 レーザ加工機として好適なものであり、更に、レーザ側 長器にも応用可能である。

2

[0002]

【従来の技術】半導体レーザは、近年の高出力半導体レーザの開発に伴い、従来の光通信や情報機器等の小出力用の応用分野だけでなく。加工用などの高出力の固体レーザの励起用光源としての応用が本格的に注目されるようになってきている。古くから用いられてきた固体レーザの励起用光源は、フラッシュランプであったが、その発光スペクトルは非常にブロードであるため、固体レーザ媒質の吸収波長帯に同調させ効率良く励起することが不可能であった。

【0003】また、固体レーザの吸収液長帯以外の光エネルギーは、固体レーザ媒質内で熱エネルギーとなり、固体レーザ媒質の熱レンズ効果等の発生により、ビーム品質の低下を招く問題が発生していた。一方、半導体レーザの発光スペクトルは狭く、固体レーザ媒質の吸収スペクトル帯に同調させることが可能であり、高効率な励起が実現できる。

【0004】例えば、フラッシュランブ励起に比べ、10倍以上の20~30%の高効率が可能であり。高出力分野で利用されてきたガスレーザをも上回るものであるため。その高出力化の開発が加速されてきている。また、効率アップにより、設備容量が低下するため。コストが低減され高出力、加工機市場への進出が可能となる。

【0005】加工用の高出力固体レーザ励起源として、 半導体レーザを用いる場合、半導体レーザの1発光素子 (1活性媒質)で活性させるのは現実的ではなく、複数 個の半導体レーザの発光素子を組み合わせて高出力化を 達成することができる。但し、固体レーザ媒質は、ある 有限の大きさ(必要な出力を取り出すために最適化され た大きさ)があるため、そのスペースに合った高密度な 半導体レーザの発光素子の組み合わせと半導体レーザ自 身の高出力化が達成されなければならない。

【0006】その構成として、一次元に活性媒質が並んだ一次元半導体レーザアレイ素子を複数個結層することによって、二次元半導体レーザアレイ素子が構成され、高密度な半導体レーザを得ることができる。また、半導体レーザ自身の高出力化に対しては、半導体レーザの平均駆動電流値を増大させることにより、達成することが可能である。

【0007】ここで問題となるのは、半導体レーザの意 気-光変換効率は、100%ではなく、ほぼ50%程度 であり、半導体レーザの抵抗をRとすれば、(IR*-レーザ出力)が熱となって発生することである。二次元 半導体レーザアレイにおいては、周囲の部分は放熱でき 50 るが、内部の部分は熱がこもり、半導体レーザの活性媒 質の温度は上昇する。また、平均駆動電流の増加に伴い、発生熱量は増大し、同様に温度上昇する。

【0008】半導体レーザの発振特性(効率、波長)は、温度依存性があり、温度上昇により、発振効率が低下し、発振波長も長波長側へシフトする。このために、更に温度上昇が加速され、最後には活性媒質中に流れる電流密度に不均一性が表れ、発振が低下し、半導体レーザに損傷を受けることとなる。従って、半導体レーザの発振が関題を解決することができれば、高出力半導体レーザの発振が可能となる。

【0009】従来の二次元半導体レーザアレイ素子の一例を図11に示す。同図に示すように、複数の冷却プロック131、132、133、134がそれぞれ中間水路12を部分的に介して積み重ねられると共に最も上の冷却プロック131上にはマニホールド6が载置されている。

【0010】各冷却ブロック131~134は、冷却水の流通する水路が複数個加工されたマイクロチャンネル3、4、5を三層に結み重ねて組み立てたものである。 尚、冷却ブロック131~134の積み重ね個数は、実 20際には、数10個である(例えば、50個~100個)。

【0011】各冷却ブロック131~134における上層のマイクロチャンネル3上には、一次元半導体レーザアレイ素子1が搭載されると共にその素子1の上下には陽極及び陰極(図示省略)が配置され、これらの電極に導線2が接続している。一次元半導体レーザアレイ素子1は、数μm×数100μmの断面積を持った数10個の活性媒質を一次元に並べて配置したものである。

【0012】一次元半導体レーザアレイ素子1に対しては、 導線2を介して駆動電流が、矢印7に示すように上段の冷却ブロック131から流入し、 更に、矢印8に示すように下段の冷却ブロック134へと流れる。一次元半導体レーザアレイ素子1に駆動電流が注入されると、 図中に示すように、レーザ11を出射し、その際、一次元半導体レーザアレイ素子1から発生する熱はマイクロチャンネル3との接触面を通じて、マイクロチャンネル3により熱を奪われて冷却されることになる。

[0013]上記マニホールド6は、外部の冷却水循環器から、注入方向9で示す方向に冷却水を注入する閉口部と、冷却ブロック131~134を通過した冷却水を再び、注出方向10で示す方向に注出するための閉口部を備えたものである。中間水路12は、冷却水を流す水路が複数形成された電導性のものであり、同時に、マイクロチャンネル3上の導線2とマイクロチャンネル5との接触を回避する役目を果たすものである。

【0014】従って、マニホールド6に、注入方向9で 示す方向より冷却水を注入すると、その冷却水は、冷却 ブロック131、132、133、134及びそれらの 間の中間水路12を図中下向えに液通した後、再び、反 転して冷却プロック134、133、132,131及 びそれらの間の中間水路12を上向きに流れ、注出方向 10で示すように排出されることとなる。

【10015】このように、冷却水を冷却ブロック131~134を流通させることにより、一次元半導体レーザアレイ素子1で発生した熱が除去され、高出力高密度な半導体レーザの発振が可能となる。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図11 に示す従来の二次元半導体レーザアレイ素子では、冷却水により、一次元半導体レーザアレイ素子1を冷却することができるものの、更に、平均駆動電流を増加して、高出力な半導体レーザを発振させると、半導体レーザの温度が上昇し、通常運転時の温度より高い温度で動作することになる。

[0017]従って、固体レーザの吸収のピーク値を示す波長の半導体レーザを採用すると、高出力運転時は温度上昇により、更に、長波長側へシフトするため、固体レーザ媒質の吸収波長との同調ができなくなり、励起効率が低下する。即ち、通常の運転では、図12に破機で示すNdイオンの吸収スペクトル分布13は、実根で示す常温での一次元半導体レーザアレイ素子の発振スペクトル14に対して、ピーク波長において同調(入。。= 入,) させることができる。

【① 0 1 8】しかしながら、高出力運転時における一次元半導体レーザアレイ素子の発振スペクトル15は、常温のときよりも図中矢印で示すように長波長側に移動するため、ピーク波長において同調できず(入。<入、)、励起効率が低下する

【0019】具体的には、YAG結晶中にドープされた Ndイオンの吸収ピーク値を示す波長は、808 n mで あるため、発光強度が808 n mでピークの半導体レー ザ素子を採用するとすると、高出力運転時は温度上昇の ため、808 n mより長波長側へシフトする。変化率を 約0.3 n m/℃とすれば、10℃の温度上昇で3 n m 長波長側へシフトし、そのために、Ndイオンの吸収波 長との同調ができず、励起効率が低下する。

【0020】また、図11に示す従来の二次元半導体レーザアレイ素子では、冷却水が反転して流れるため、一次元半導体レーザアレイ素子1の温度が不均一となる不都合がある。即ち、マニホールド6に注入された冷却水は、最上段の冷却ブロック131のマイクロチャンネル3、4、5をスタートして、冷却ブロック132、133を順に流下した後、最下段の冷却ブロック134のマイクロチャンネル3、4、5を通って反転し、冷却ブロック133、132を流上し、最上段の冷却ブロック131に戻って、マニホールド6から外部へ注出されることになる。

ブロック131、132、133、134及びそれらの 【0021】従って、冷却ブロック131の冷却水の温 間の中間水路12を図中下向きに流通した後、再び、反 50 度よりも、冷却ブロック134の冷却水の温度が高くな り、一次元半導体レーザアレイ素子 1 が不均一となる。 そのため、より高い温度の一次元半導体レーザアレイ素 子 1 の発振波長はより長波長側へシフトすることにな り、発振スペクトルの幅が広がることになる。即ち、通 常の運転では、図 1 2 に破線で示すNdイオンの吸収ス ペクトル分布 1 3 は、実線で示す常温での一次元半導体 レーザアレイ素子の発振スペクトル 1 4 に対して、半値 全幅においても同調(Δ λ 。 = Δ λ 。) させることがで きる。

【0022】しかしながら、高出力運転時における一次 10元半導体レーザアレイ素子の発振スペクトル15は、常温のときよりも発振スペクトル幅が広がるため、半値全幅においても同調できず(△)、<△)、 励起効率が低下する

具体的には、YAG結晶中にドープされたNdイオンの 吸収スペクトルのピーク値を示す波長は、808 nmで あり、その拡がりを示す半値全幅△λ、≒3 nm程であ る。

【0023】一方、通常の一次元半導体アレイ素子の常温における発振スペクトルの半値全幅も△入、≒3nmであるため、温度上昇により、更に発振スペクトル幅が広がると、△入、>3nmとなり、スペクトル幅においても同調しなくなるため、励起効率が低下する。更に、冷却プロック131~134におけるマイクロチャンネル3、4、5はでは、複数の流路を形成し、流路断面積を福小してゆくことにより、ベンチェリー効果を発生させ、流速の増加が期待されるが、逆に断面積が福小することにより、圧力損失も増加し、注入口での水圧を増加させないと、除熱に充分な流速が確保できなくなり、冷却水循環設備容量の増大にもつながる。

【10024】また、分割されたマイクロチャンネル3, 4、5の接台部の気密性の関値が増大し、冷却水漏れの 発生原因の増大につながる。更に、複数の冷却水通路を 形成するためには、加工工数の増加、エッチング等によ る効果な加工法の採用の必要があり、加工コストの増加 につながり、半導体レーザ励起固体レーザの高効率発振 のメリットが低減される。

【10025】また、一次元半導体レーザアレイ素子1に 駆動電源導入用の導根2を保護するための各々中間水路 12を介在しているため、高密度な二次元半導体レーザ アレイ素子化が困難となっている。

[0026]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本発明は、次の手段を採用する。

◎一次元半導体レーザアレイ素子の高出力選転時における温度上昇による液長シフトを考慮し、固体レーザ媒質の吸収ピーク液長よりも短波長側で発振スペクトルのピーク値を示す半導体レーザを励起用光源として採用した点。

【0027】②一次元半導体レーザアレイ素子を冷却す 50 ない陽極、陰極をそれぞれ配置している。

る冷却用マイクロチャンネルにおいて、冷却水は一方向 のみに流れ、注入側と注出側にそれぞれマニホールドを 設置し、注入用のマニホールドに注入された冷却水は、 それぞれ、一つの一次元半導体レーザアレイ素子用冷却 水路を重複して流れることなく、注出用マニホールドに 排出される構造とした点。

6

【10028】 ③冷却用マイクロチャンネルとして、単一 流路を採用すると同時に一体物を用いた点。

◎一次元半導体レーザアレイ素子の上下面に陽極. 陰極を設置し、冷却用マイクロチャンネルに直に接合させる占.

[0029]

【発明の実施の形態】先ず、一つの一次元半導体レーザアレイ素子の高出力運転時の温度上昇による長波長側への波長シフト量を Δ とすると、固体レーザ媒質の吸収スペクトルのビーク値を示す波長より同量の Δ λ だけ、短波長に発振のビークを持つ一次元半導体レーザアレイ素子を励起用光源として採用することにより、高出力運転時には、固体レーザ媒質の吸収スペクトルのビーク値を示す波長までシフトするため、波長の同調が可能である

【0030】次に、一次元半導体レーザアレイ素子を冷却する冷却用マイクロチャンネルは単一水路で流れ方向も1方向のみとし、注入側と注出側に各ャマニホールドを設置することにより、注入された冷却水が各々一つの冷却用マイクロチャンネルを流れ、注出用マニホールドへ排出されるため、積層された各々の一次元半導体レーザアレイ素子は同一の温度の冷却水で冷却され、温度上昇も同一となる。また、単一流路と一体型冷却用マイクのチャンネルの採用により、低圧の損失、加工工数低減、容易な加工法の採用が可能である。

[0031]

【実施例】以下、本発明に付いて、図面に示す実施例を 参照して詳細に説明する。本発明の第1の実施例に係る 固体レーザ励起用半導体レーザを図1に示す。同図に示 すように、冷却用マイクロチャンネル16が多数積み上 げられると共にこれら冷却用マイクロチャンネル16の 間に絶縁体17と一次元半導体レーザアレイ素子1とが 平面的に重なり合わないように並べて介装され、また、 冷却用マイクロチャンネル 16と一次元半導体レーザア レイ素子』とが電気的及び物理的に接着されて二次元半 導体レーザアレイ素子が構成されている。 【0032】更に、このように構成された二次元半導体 レーザアレイ素子の両側面に往入用マニホールド18、 往出用マニホールド19が一直に取り付けられている。 ―次元半導体レーザアレイ素子 1 としては、例えば、数 μm×数100μmの断面積を持った数10個の活性媒 質を一次元に並べて配置したものを用いることができ る。一次元半導体レーザ素子の上面。下面には、図示し

【1) () 33】冷却用マイクロチャンネル16と一次元半 導体レーザアレイ素子1とを接着する接着材としては、 導電性の高い材料が用いられる。冷却用マイクロチャン ネル16は、絶縁冷媒である冷却水を一方向のみに通過 させる単一流路であり、導電性材料よりなる。また、冷 却用マイクロチャンネル16は、一体物として成形さ れ、接合部は設けられていない。

【10034】更に、冷却用マイクロチャンネル16は、 相互に接続されていないので、冷却用マイクロチャンネ ル16の間での冷却水の流出入はない。注入用マニホー 10 ルド18は、外部から図中矢印9で示す方向より供給さ れる冷却水を多数の冷却用マイクロチャンネル16に対 して並列的に注入するものであり、また、注出用マニホ ールド19は、多数の冷却用マイクロチャンネル16を 流れた冷却水をまとめて図中矢印10で示す方向の外部 へ注出するものである。マニホールド18, 19は何れ も絶縁材で構成される。

【1)135】従って、注入用マニホールド18から多数 の冷却用マイクロチャンネル16に対して冷却水が並列 的に注入されると、この冷却水は、各マイクロチャンネ ル16を同一方向へ流れ、他のマイクロチャンネル16 へ分岐することもなく、また、台流することもなく並列 的に流れて (パラレルフロー方式) 注出用マニホール ド19で集合して排出されることになる。ここで、冷却 水は、各々の冷却チャンネル16のほぼ同一距離を同一 時間で同一方向に流れ、各々の一次元半導体レーザアレ イ素子1で発生した熱を均一に奪うことになる。

【()()36】尚、何れかの冷却用チャンネル16を通過 した冷却水は、再び、他の冷却用チャンネル16を通過 することなく、外部の循環器へ排出される。従って、一 次元半導体レーザアレイ素子1で発生する熱量が同一で あれば、冷却用マイクロチャンネル16を流れる冷却水 の水温が均一であるため、高出力運転時においても、各 ャの一次元半導体レーザアレイ素子 1 の温度上昇も同一 となり、そのため、波長シフト量も同一となる。

【0037】そのため、二次元半導体レーザアレイ素子 として複数個積層したとしても、半導体レーザの発振ス ベクトルのピーク値を示す波長は長波長側へ移動した後 も全て同一なレーザ光が得られる。一方、二次元半導体 レーザアレイ素子に対して、図1に矢印7、8で示すよ うに上方から下方へと駆動電流を流すと、導電性材料よ りなる冷却用マイクロチャンネル16を経て、一次元半 導体レーザアレイ素子1の陽極からその陰極のみに流 れ、更に、その下段の冷却用マイクロチャンネル16へ と流れ、これを積層された分だけ直列的に流れ、最下段 の冷却用マイクロチャンネル16から外部へ流れる。 【りり38】これにより、全ての一次元半導体レーザア

レイ素子1に対して駆動電流を流すことが可能となり、 各一次元半導体レーザアレイ素子1からはレーザ11か 出力される。尚、絶縁材17、往入用マニホールド18 50 んで、冷却用マイクロチャンネルAを積層し、同様のブ

及び注出用マニホールド19は、絶縁性であり、また、 冷却水は絶縁冷媒であるので、これらには通電される虞 はない。

8

【0039】図2に、YAG結晶にドープされたNaイ オンの吸収スペクトルと半導体レーザの発振スペクトル の同調を示す。同図に破線で示すNdイオンの吸収スペ クトル分布13は、入。=808mmにおいて吸収のピ ーク値を示し、また、そのときの半値全幅はΔλ.。≒3 nn程度である。

【()()()4() 】同図に実線で示す常温での通常進転時の 一次元半導体レーザアレイ素子の発振スペクトル分布2 ()は、半値全幅 Δ λ, 5 3 n in 程度であるが、ピーク値 を示す波長は、高出力運転時における半導体レーザの温 度上昇したときの波長シフト量△入分だけ、Ndイオン の吸収スペクトルのピーク値を示す波長入.。= 808n mより、短波長側に設定されている。

【()()41】例えば、波長の温度に対する変化率が(). 3mm/℃のとき、高出力運転時に10℃の温度上昇す る冷却設計をした場合、3 nmだけ短波長の805 nm にビークを示す発振スペクトルを有する一次元半導体レ ーザアレイを採用するのである。これにより、高出力運 転時に半導体レーザの温度が10℃上昇し、図中矢印で 示すように3n mだけ長波長側へ発捩スペクトル21が ずれると、Ndイオンの吸収スペクトルのビーク波長と 同調させることができる。

【りり42】しかも、二次元アレイ化された全ての一次 元半導体レーザアレイ素子の発振スペクトル分布形状と ピーク波長が同一であるため、Ndイオンの半値全幅A え,と発振スペクトルの△入,とは一致し、また。ビーク 波長 λ_{**} = λ_{**} で一致するため、波長同調が可能とな

【()()43】本実施例に係る二次元半導体レーザアレイ 素子の製造プロセスを図3~図10に示す。先ず、図3 に示すように、単一流路である冷却用マイクロチャンネ ルAを水平に置き、更に、図4に示すように、冷却用マ イクロチャンネルAの上の一次元半導体レーザアレイ素 子が設置されるスペース以外の面には絶縁シート(商品 名:カプトン、厚さり、3mm)Bを貼付し、一次元半 導体レーザアレイ素子が設置されるスペースにはインジ ウムシート (11mm×6mm×0.01mm) Cを配 置する。

【()()44】次に、図5に示すように、冷却用マイクロ チャンネルAの上のインジウムシートCの上に、一次元 半導体レーザアレイ素子(11mm×6mm×0.28 mm) Dを積層し、更に、図6に示すように、一次元半 導体レーザアレイ素子Dの上に、インジウムシートCを 積層する。

【0045】引き続き、図7に示すように、一次元半導 体レーザアレイ素子D及びインジウムシートCを間に挟

特開平9-181376

10

ロセスを繰り返して、固体レーザ媒質を励起するに必要な分だけ積層して二次元半導体レーザアレイ素子とする。

【0046】その後、図8に示すように、二次元半導体レーザアレイ素子(42スタック、180mm)を流路方向と垂直な面の合わせを行った後、二つの支持ブロックEで挟み、その支持ブロックEの両端にボルトFを貫通し、該ボルトFをナットGで締付けトルク7gfm を加えて締付けた。この締付けトルクは、半導体レーザ素子内の多層膜等を圧力により損傷させないために管理 10されている。

【0047】更に、図9に示すように、固定された二次元半導体レーザアレイ素子の発光端部を上向さにしてホットプレート等の加熱板に載せて、Nェ+Hェ雰囲気中で200℃まで加熱し、融点156℃のインジウムシートでを溶解させ、その後、加熱を停止し冷却することにより、インジウムシートでを再び固化して導電性接着剤として構能させる。同様に2セット分を作製する。最後に、図10に示すように、二次元半導体レーザアレイ素子の両側面に、絶縁材であるアクリル又はテフロンよりなる注入用、注出用マニホールド日を各ヶ接着剤にて接台する。

[0048]

【発明の効果】以上、実施例に基づいて具体的に説明したように、本発明によれば、次の効果を奏する。

②固体レーザ媒質の吸収スペクトルと高出力励起用半導体レーザの発振スペクトルの同調ができ、高効率で高出力の固体レーザ発振が達成できる。

②単一流路、流路方向統一、流路形状同一させ、1体物の冷却用マイクロチャンネルを採用することにより、安 30 価で漏水要因の低減が可能となる。

③一次元半導体レーザアレイ素子と冷却用マイクロチャンネルを直に電気的、物理的に接着させるため。コンパクトで高密度な二次元半導体レーザアレイ素子が達成できる。

【図面の簡単な説明】

*【図1】本発明の第1の実施例に係る二次元半導体レーザアレイ素子の斜視図である。

【図2】本発明の第1の実施例に係るNd:YAGの吸収スペクトル分布と半導体レーザ素子の発光スペクトルの分布を示すグラフである。

【図3】二次元半導体レーザアレイ素子の製造プロセス を示す工程図である。

【図4】二次元半導体レーザアレイ素子の製造プロセスを示す工程図である。

0 【図5】二次元半導体レーザアレイ素子の製造プロセス を示す工程図である。

【図6】二次元半導体レーザアレイ素子の製造プロセスを示す工程図である。

【図7】二次元半導体レーザアレイ素子の製造プロセスを示す工程図である。

【図8】二次元半導体レーザアレイ素子の製造プロセス を示す工程図である。

【図9】二次元半導体レーザアレイ素子の製造プロセスを示す工程図である。

0 【図10】二次元半導体レーザアレイ素子の製造プロセスを示す工程図である。

【図11】従来の二次元半導体レーザアレイ素子を示す 斜視図である。

【図12】Nd:YAGの吸収スペクトル分布と半導体レーザ素子の発光スペクトルの分布を示すグラフである。 【符号の説明】

1 一次元半導体レーザアレイ素子

7 駆動電流流入方向

8 駆動電流流出方向

9 冷却水注入方向

10 冷却水注出方向

11 1発光素子のレーザ

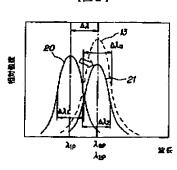
16 単一流路冷却マイクロチャンネル

17 絶縁材

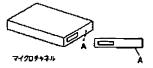
18 冷却水注入用マニホールド

19 冷却水注出用マニホールド

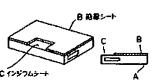
[図2]



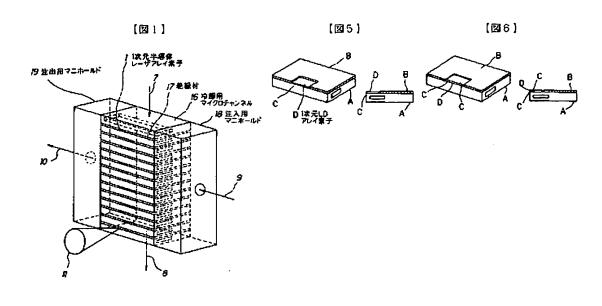
[図3]

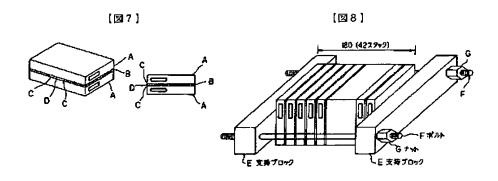


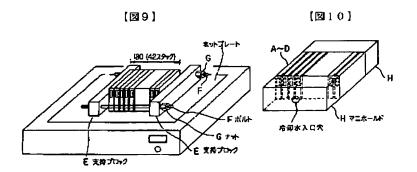
[図4]



特開平9-181376







(8)

特開平9-181376

